

# アルミベース銅張積層板 Aluminum Based materials for PCB ALC-1371

- 特徴**
- ・高熱伝導 (絶縁層部分の熱伝導 7W/mk)
  - ・低熱抵抗
  - ・ハロゲンフリー材
  - ・耐トラッキング性CTI値600V
  - ・高耐電圧

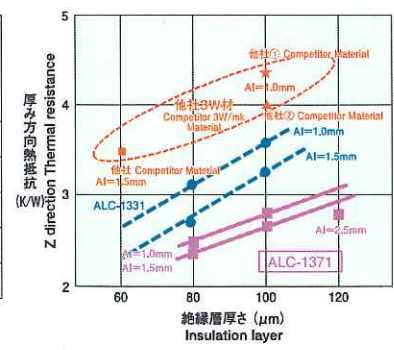
- Features**
- ・High Thermal conductivity (7W/mk Part of Insulation Layer)
  - ・Low Thermal resistance
  - ・Halogen Free material
  - ・Anti Tracking material CTI 600V<
  - ・High Withstand Voltage

- 用途**
- ・パワーモジュール
  - ・車載電動パワーステアリング

- Application**
- ・Power Module
  - ・Electric Power Steering

## 熱抵抗 Thermal resistance

品番 Item	構成 Composition			厚み方向 Z direction 熱抵抗 Thermal resistance K/W
	アルミ Aluminum mm	絶縁層 Insulation Layer μm	銅箔 Copper μm	
ALC-1371	1.0	80	35	2.5
	1.0	100	35	2.8
	1.5	80	35	2.4
	1.5	100	35	2.7
	2.5	120	35	2.8

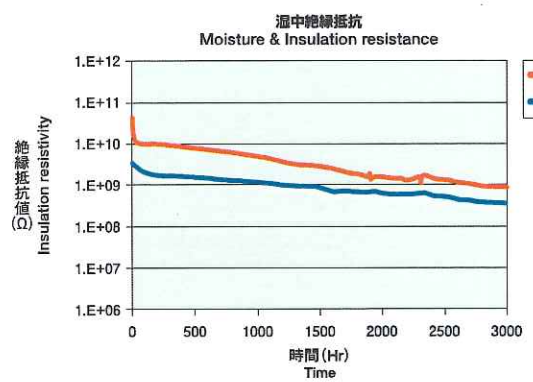


## 連続運転中 層間絶縁抵抗評価

サンプル: ALC-1371 銅箔35μm/絶縁層80,120μm/アルミニウム1.0mm  
100mm角, φ25mm銅箔パターン  
処理条件: 85°C, 85%RH, DC100V印加  
測定: 試験槽内(85°C, 85%)にて3時間毎測定(リーク検出)

## Interlayer Insulation resistance

Sample: Copper 35μm Insulation Layer 80,120μm  
Aluminum 1.0mm size 100mm x 100mm  
copper pattern φ25mm  
Test condition: 85°C/85%/DC100V every 3hours checking

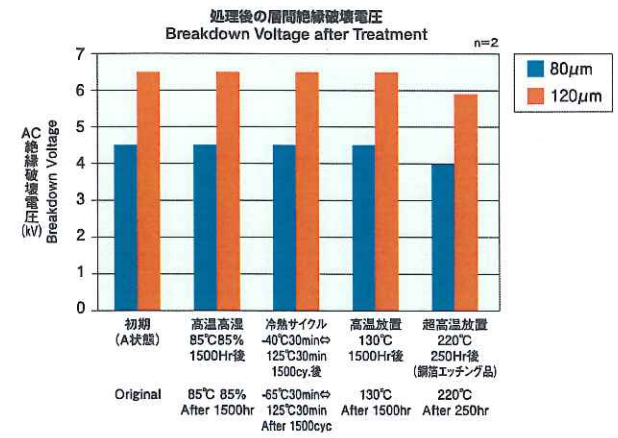


## 絶縁破壊電圧 (AC)

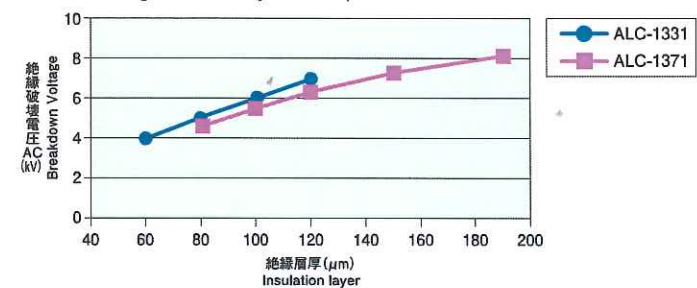
サンプル: ALC-1371 銅箔35μm/絶縁層80μm,120μm/アルミニウム1.0mm  
100mm角, φ25mm銅箔パターン  
測定条件: AC絶縁破壊電圧測定 0.5kV/sec 連続昇圧

## Breakdown Voltage

Sample: Copper 35μm Insulation Layer 80,120μm Aluminum 1.0mm  
size 100mmx100mm copper pattern φ25mm  
Test condition: AC 0.5kV/sec Continuous voltage rise



## 絶縁層厚みと絶縁破壊電圧の関係 Withstand voltage Insulation Layer 60~200μm



## v-t 試験 (125°C) v-t Test

